

主催:シリコンテクノロジー分科会  
共催:エレクトロニクス実装学会

# 2025年第73回応用物理学会 秋季学術講演会シンポジウム

開催日 2025年9/9 火

時間 13:30~17:30

Cutting-edge logic semiconductors  
and associated technologies

## 先端ロジック半導体と その周辺技術

近年、生成AIや高性能コンピューティングほか、デジタル社会の根幹を担う応用分野において、ロジック半導体の高度化・高集積化がかつてないスピードで進んでいます。これに伴い、先端ロジック半導体の設計・製造技術はもとより、材料・装置・パッケージング・冷却・信号伝送などの周辺技術に対する要求も飛躍的に高まっています。本シンポジウムでは、次世代のロジック半導体に向けた技術課題とブレークスルー、さらにはそれを支える周辺技術の最新動向について、産学の第一線で活躍する研究者・技術者を招き、議論を深めます。分野横断的な知見を共有し、将来の技術ロードマップの形成や異分野連携の契機となる場を提供いたします。

### 【招待講演者】

Opening	13:30-13:35	
若林整 (東京科学大)	13:35-14:05	GAA-NS-FETおよび3DSFET (CFET) 技術の最新動向
右田真司 (産総研)	14:05-14:35	ゲートスタックの最新動向
井上史大 (横国大)	14:35-15:05	ポストCu配線技術の動向と裏面配線対応の展望
小椋厚志 (明治大)	15:05-15:35	Beyond 2nm世代向けのエピ成長およびシリコン基板の最新動向
沓掛健太郎 (名古屋大)	15:45-16:15	半導体製造プロセス開発を加速するAI技術
トープラサートポンカシディット (東大)	16:15-16:45	HZO強誘電体メモリと新原理コンピューティングへの展開
長野方星 (名古屋大)	16:45-17:15	3D半導体チップの熱マネジメントを支える放熱デバイスと計測技術
Closing	17:15-17:20	
名刺交換会	17:20-17:30	

【代表世話人】多田宗弘(慶應義塾大学) E-mail [tada@sd.keio.ac.jp](mailto:tada@sd.keio.ac.jp)

【世話人】中塚理(名古屋大学)、角村貴昭(東京エレクトロン)  
松川貴(産総研)、園田賢一郎(ルネサス)、柴田聡(パナソニック)